(19) **日本国特許庁(JP)** 

# (12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第5218765号 (P5218765)

(45) 発行日 平成25年6月26日(2013.6.26)

(24) 登録日 平成25年3月15日(2013.3.15)

FL(51) Int. Cl.

CO9D 183/04 (2006, 01) CO9D 183/04 CO8G 77/04 (2006, 01) CO8G 77/04 CO8G 77/50 (2006.01) CO8G 77/50

請求項の数 8 (全 27 頁)

(21) 出願番号 特願2008-510872 (P2008-510872)

(86) (22) 出願日 平成19年3月28日 (2007.3.28)

(86) 国際出願番号 PCT/JP2007/056597 (87) 国際公開番号 W02007/119554

平成19年10月25日 (2007.10.25) (87) 国際公開日

平成21年8月4日(2009.8.4) 審査請求日 (31) 優先権主張番号 特願2006-89987 (P2006-89987) (32) 優先日 平成18年3月29日 (2006.3.29)

(33) 優先権主張国 日本国(JP) ||(73)特許権者 000004178

JSR株式会社

東京都港区東新橋一丁目9番2号

||(74)代理人 100090398

弁理士 大渕 美千栄

|(74)代理人 100090387

弁理士 布施 行夫

(72) 発明者 中川 恭志

東京都中央区築地5丁目6番10号 JS

R株式会社内

|(72)発明者 野辺 洋平

東京都中央区築地5丁目6番10号 JS

R株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリマーの製造方法、ポリマー、ポリマー膜形成用組成物、ポリマー膜の形成方法およびポリマ

# (57)【特許請求の範囲】

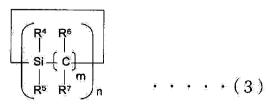
## 【請求項1】

(A)下記一般式(1)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも 1 種の加水分解 性基含有シラン化合物10~4000重量部と、(B)下記一般式(3)で表される化合 物の群から選ばれた少なくとも1種の環状シランモノマー100重量部とを加水分解して 共縮合することによって得られたポリマーと、有機溶剤と、を含有する、ポリマー膜形成 用組成物。

R<sub>a</sub>SiX<sub>4-a</sub> • • • • (1)

(式中、Rはアルキル基、アリール基、アリル基またはグリシジル基、Xはアルコキシ 基、アシロキシ基またはハロゲン元素、 a は 1 ~ 3 の整数を示す。)

【化1】



(式中、 $R^4 \sim R^7$ は同一または異なり、水素原子,ハロゲン原子,ヒドロキシル基、 アルコキシル基,アシロキシ基、スルホン基、メタンスルホン基、トリフルオロメタンス ルホン基または1価の炭化水素基、mは1~6の整数、nは1~10の整数を示す。)

## 【請求項2】

請求項1において、

さらに、前記加水分解性基含有シラン化合物として、下記一般式(2)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種を含む、ポリマー膜形成用組成物。

 $R_{b}^{1}Y_{3-b}Si-(R_{3})_{d}-SiZ_{3-c}R_{c}^{2}$ . · · · (2)

〔式中、 $R^1$  および  $R^2$  は同一または異なり、それぞれ 1 価の有機基、 B および C は同一または異なり、  $B^3$  は酸素原子,フェニレン基または - (C H B ) 。 - で表される基(ここで、 B は 1 ~ 6 の整数である)、 B および B は同一または異なり、アルコキシ基、アシロキシ基またはハロゲン元素、 B は B または 1 を示す。 B

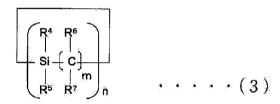
### 【請求項3】

(A)下記一般式(1<u>)で</u>表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種の加水分解性基含有シラン化合物 10~4000重量部と、(B)下記一般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種の環状シランモノマー100重量部とを、水および有機溶媒存在下で混合し、加熱<u>して、加水分解縮合する</u>ことを含む、ポリマーの製造方法。

 $R_a S i X_{4 - a} \cdots (1)$ 

(式中、R は $\underline{P}$  ルキル基、 $\underline{P}$  リール基、 $\underline{P}$  リル基またはグリシジル基、X はアルコキシ基、X はアルコキシ基、アシロキシ基またはハロゲン元素、X は 1 ~ 3 の整数を示す。)

### 【化2】



(式中、 R $^4$  ~ R $^7$  は同一または異なり、水素原子,ハロゲン原子,ヒドロキシル基、アルコキシル基,アシロキシ基、スルホン基、メタンスルホン基、トリフルオロメタンスルホン基または 1 価の炭化水素基、 m は 1 ~ 6 の整数、 n は 1 ~ 1 0 の整数を示す。)

# 【請求項4】

請求項3において、

<u>さらに、前記加水分解性基含有シラン化合物として、下記一般式(2)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種を含む、ポリマーの製造方法。</u>

 $R_{b}^{1}Y_{3-b}Si-(R_{d}^{3})_{d}-SiZ_{3-c}R_{d}^{2}$  . . . . . (2)

## 【請求項5】

請求項3または4に記載の製造方法によって得られるポリマー。

### 【請求項6】

請求項<u>1または2</u>に記載のポリマー膜形成用組成物を基板に塗布し、30~450 に 40 加熱することを含む、ポリマー膜の形成方法。

# 【請求項7】

請求項<u>1または2</u>に記載のポリマー膜形成用組成物を基板に塗布し、<u>電子線、紫外線、</u>X線から選ばれる少なくとも1種の照射下で30~450 に加熱することを含む、ポリマー膜の形成方法。

### 【請求項8】

請求項6または7に記載の形成方法により得られる、シリカ系のポリマー膜。

【発明の詳細な説明】

# 【技術分野】

[0001]

10

20

30

本発明は、ポリマーの製造方法、ポリマー、ポリマー膜形成用組成物、ポリマー膜の形成方法およびポリマー膜に関する。

### 【背景技術】

### [0002]

従来、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、CVD(Chemical Vapor Deposition)法などの真空プロセスで形成されたシリカ( $SiO_2$ )膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間絶縁膜が開発されている。

[0003]

特に半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低比誘電率でかつクラック耐性、機械的強度に優れた層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

[0004]

低比誘電率の材料としては、アンモニアの存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子とアルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物からなる組成物(特開平5-263045号公報、特開平5-315319号公報)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物をアンモニアの存在下で縮合することにより得られた塗布液(特開平11-34021号公報、特開平11-340220号公報)が提案されている。しかしながら、これらの方法で得られる材料は、反応の生成物の性質が安定せず、塗膜の比誘電率、クラック耐性、機械的強度、密着性などのバラツキも大きいため、工業的生産には不向きであった。また、ポリカルボシラン溶液とポリシロキサン溶液を混合することにより塗布液を調製し、低誘電率絶縁膜を形成する方法(特開2001-127152号公報)が提案されているが、この方法ではカルボシランとシロキサンのドメインが不均一な状態で塗膜中にそれぞれ分散してしまうという問題があった。

[0005]

さらに、近年の半導体装置の製造プロセスにおいては、膜の平坦化を目的としてCMP(Chemical Mechanical Polishing)工程が用いられている。そのため、絶縁膜材料に高いCMP耐性が求められている。また、半導体装置の製造プロセスにおいては、層間絶縁膜のエッチングあるいはレジストのアッシングの後に洗浄が行われ、この洗浄工程では、希フッ酸等の薬液が用いられる。そのため、絶縁膜材料には、高い薬液耐性が求められている。

[0006]

既に我々は、(A)加水分解性基含有シラン化合物および/またはその加水分解縮合物と、(B)環状シラン化合物とを混合し、加熱することで半導体製造プロセスに対する耐性を向上する方法を提案しているが(特開2005-200571号公報)、ポリマー構造中において1つのケイ素原子に4つの酸素が置換した部位が存在する場合、前記部位のないものと比較して上記プロセス耐性が劣ることが問題であった。

【発明の開示】

[0007]

本発明は、均一な膜質が得られ、さらに比誘電率が小さく、機械的強度、CMP耐性および薬液耐性に優れた絶縁膜を形成できるポリマーの製造方法およびポリマーを提供することにある。

[0008]

本発明の他の目的は、前記本発明のポリマーを用いたポリマー膜形成用組成物、ポリマー膜の形成方法およびポリマー膜を提供することにある。

### [0009]

本発明に係るポリマーの製造方法は、

20

10

30

40

(A)下記一般式(1)および(2)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種 の加水分解性基含有シラン化合物と、(B)下記一般式(3)で表される化合物の群から 選ばれた少なくとも1種の環状シランモノマーとを共縮合することによって得られたポリ マーと、有機溶剤と、を含有する、ポリマー膜形成用組成物を含む。

# [0010]

R<sub>a</sub>SiX<sub>4-a</sub> • • • • (1)

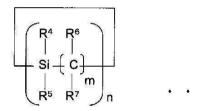
(式中、 R は水素原子 , フッ素原子または 1 価の有機基、 X はアルコキシ基、アシロキ シ基またはハロゲン元素、 a は 1 ~ 3 の整数を示す。)

 $R_{b}^{1}Y_{3-b}Si-(R^{3})_{d}-SiZ_{3-c}R^{2}_{c}$  · · · (2)

〔式中、 $R^{-1}$  および $R^{-2}$  は同一または異なり、それぞれ1 価の有機基、B および C は同 ーまたは異なり、 0 ~ 3 の整数を示し、 R  $^3$  は酸素原子,フェニレン基または - ( C H  $_2$ ) e - で表される基 ( ここで、 e は 1 ~ 6 の整数である ) 、 Y および Z は同一または異な り、アルコキシ基、アシロキシ基またはハロゲン元素、dは0または1を示す。〕

### [0011]

# 【化3】



20

(式中、 $R^4 \sim R^7$  は同一または異なり、水素原子,ハロゲン原子,ヒドロキシル基、 アルコキシル基,アシロキシ基、スルホン基、メタンスルホン基、トリフルオロメタンス ルホン基または1価の炭化水素基、mは1~6の整数、nは1~10の整数を示す。)

# [0012]

(A)下記一般式(1)および(2)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1 種の加水分解性基含有シラン化合物と、(B)下記一般式(3)で表される化合物の群か ら選ばれた少なくとも1種の環状シランモノマーとを、有機溶媒存在下で混合し、加熱す ることを含む。

# [0013]

• • • • (1) R<sub>a</sub>SiX<sub>4 a</sub>

(式中、 R は水素原子, フッ素原子または 1 価の有機基、 X はアルコキシ基、アシロキ シ基またはハロゲン元素、aは1~3の整数を示す。)

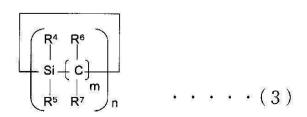
# [0014]

 $R_{b}^{1}Y_{3-b}Si-(R_{b}^{3})_{d}-SiZ_{3-c}R_{b}^{2}$ . · · · (2)

〔式中、 $R^{-1}$  および $R^{-2}$  は同一または異なり、それぞれ1価の有機基、B および C は同 ーまたは異なり、0~3の整数を示し、 $R^3$ は酸素原子,フェニレン基または - ( $CH_2$ )。- で表される基(ここで、 e は 1 ~ 6 の整数である)、 Y および Z は同一または異な り、アルコキシ基、アシロキシ基またはハロゲン元素、dは0または1を示す。〕

## [0015]

## 【化4】



(式中、 $R^4 \sim R^7$  は同一または異なり、水素原子,ハロゲン原子,ヒドロキシル基、

10

30

40

アルコキシル基 , アシロキシ基、スルホン基、メタンスルホン基、トリフルオロメタンスルホン基または 1 価の炭化水素基、mは 1 ~ 6 の整数、n は 1 ~ 1 0 の整数を示す。 )

### [0016]

本発明に係るポリマーの製造方法によれば、(A)加水分解性基含有シラン化合物および/またはその加水分解縮合物と、(B)環状シランモノマーとを混合し、加熱することにより、ポリシロキサンとポリカルボシランとが複合化されたポリマーを得ることができる。このポリマーは、ポリシロキサンとポリカルボシランとをブレンドした場合のように、膜中に相分離を発生することがない。このような特定のポリマーを含有する膜形成用組成物を用いることにより、比誘電率が小さく、機械的強度、CMP耐性ならびに薬液耐性に優れたポリマー膜を得ることができる。

10

## [0017]

本発明に係るポリマーは、上述した本発明に係る製造方法によって得られる。

#### [0018]

本発明に係るポリマー膜の形成方法は、本発明に係るポリマー膜形成用組成物を基板に 塗布し、30~450 に加熱することを含むことができる。

### [0019]

本発明に係るポリマー膜の形成方法は、本発明に係るポリマー膜形成用組成物を基板に 塗布し、高エネルギー線の照射下で30~450 に加熱することを含むことができる。

#### [0020]

本発明に係るシリカ系のポリマー膜は、本発明に係るポリマー膜の形成方法により得られる。

20

【発明を実施するための最良の形態】

### [0021]

以下、本発明をさらに詳細に説明する。

### [0022]

本発明のポリマーは、例えば、前記一般式(1)および(2)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物と、前記一般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種の環状シランモノマーとを、有機溶媒中で触媒の存在下で混合し、加熱して得られる。

[0023]

30

1.加水分解性基含有シラン化合物

まず、一般式(1)または(2)で表されるシラン化合物について説明する。

### [0024]

1.1.一般式(1)で表される化合物

前記一般式(1)において、Rは水素原子,フッ素原子または1価の有機基である。1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。また、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であることが好ましい。

## [0025]

ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ビニル基などが挙げられ、好ましくは炭素数 1 ~ 5 である。これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。

40

## [0026]

アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基 、クロロフェニル基、プロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる

0

### [0027]

また、前記一般式(1)において、Xはアルコキシ基、アシロキシ基またはハロゲン原子である。Xのアルコキシル基の炭化水素部位については、Rの1価の有機基として挙げられたものを例示できる。

20

30

40

50

### [0028]

一般式(1)で表される化合物(以下、「化合物1」ともいう)の具体例としては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリ・n・プロポキシシラン、トリ・iso・プロポキシシラン、トリ・n・ブトキシシラン、トリ・sec・ブトキシシラン、トリ・tert・ブトキシシラン、トリフェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリ・iso・プロポキシシラン、フルオロトリ・n・ブトキシシラン、フルオロトリ・sec・ブトキシシラン、フルオロトリ・tert・ブトキシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど;

# [0029]

メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ-n-プロポキシ シラン、メチルトリ・iso‐プロポキシシラン、メチルトリ・n‐ブトキシシラン、メ チルトリ - sec - ブトキシシラン、メチルトリ - tert - ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルト リ・n - プロポキシシラン、エチルトリ・i s o - プロポキシシラン、エチルトリ・n -ブトキシシラン、エチルトリ・sec‐ブトキシシラン、エチルトリ・tert‐ブトキ シシラン、エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキ シシラン、ビニルトリ・n・プロポキシシラン、ビニルトリ・iso・プロポキシシラン 、ビニルトリ・n-プトキシシラン、ビニルトリ-sec-プトキシシラン、ビニルトリ - tert - ブトキシシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n - プロピルトリメトキシ シラン、n - プロピルトリエトキシシラン、n - プロピルトリ - n - プロポキシシラン、 n - プロピルトリ - i s o - プロポキシシラン、n - プロピルトリ - n - ブトキシシラン 、n-プロピルトリ-sec-ブトキシシラン、n-プロピルトリ-tert-ブトキシ シラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-プロピルトリメトキシシラン、i-プ ロピルトリエトキシシラン、i - プロピルトリ - n - プロポキシシラン、i - プロピルト リ-iso-プロポキシシラン、i-プロピルトリ-n-ブトキシシラン、i-プロピル トリ・sec‐ブトキシシラン、i‐プロピルトリ・tert‐ブトキシシラン、i‐プ ロピルトリフェノキシシラン、n - ブチルトリメトキシシラン、n - ブチルトリエトキシ シラン、n‐ブチルトリ‐n‐プロポキシシラン、n‐ブチルトリ‐iso‐プロポキシ シラン、n‐ブチルトリ‐n‐ブトキシシラン、n‐ブチルトリ‐sec‐ブトキシシラ ン、n - ブチルトリ - tert - ブトキシシラン、n - ブチルトリフェノキシシラン、s e c - ブチルトリメトキシシラン、 s e c - ブチルトリエトキシシラン、 s e c - ブチル - トリ・n - プロポキシシラン、sec - ブチル・トリ・i so - プロポキシシラン、s e c - ブチル - トリ - n - ブトキシシラン、 s e c - ブチル - トリ - s e c - ブトキシシ ラン、 s e c - ブチル - トリ - t e r t - ブトキシシラン、 s e c - ブチル - トリフェノ キシシラン、t‐ブチルトリメトキシシラン、t‐ブチルトリエトキシシラン、t‐ブチ ルトリ - n - プロポキシシラン、t‐ブチルトリ‐iso‐プロポキシシラン、t‐ブチ ルトリ - n - ブトキシシラン、t - ブチルトリ - s e c - ブトキシシラン、t - ブチルト リ・tert‐ブトキシシラン、t‐ブチルトリフェノキシシラン、フェニルトリメトキ シシラン、フェニルトリエトキシシラン、フェニルトリ-n-プロポキシシラン、フェニ ルトリ - i s o - プロポキシシラン、フェニルトリ - n - ブトキシシラン、フェニルトリ - s e c - ブトキシシラン、フェニルトリ - t e r t - ブトキシシラン、フェニルトリフ ェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 - アミノプ ロピルトリメトキシシラン、 - アミノプロピルトリエトキシシラン、 - グリシドキシ プロピルトリメトキシシラン、 - グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、 - トリ フロロプロピルトリメトキシシラン、 - トリフロロプロピルトリエトキシシランなど; [0030]

ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチル・ジ・n・プロポキシシラン、ジメチル・ジ・iso・プロポキシシラン、ジメチル・ジ・n・プトキシシラン、ジメチル・ジ・tert・プトキシシラン

20

30

40

50

、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン 、ジエチル・ジ・n・プロポキシシラン、ジエチル・ジ・iso・プロポキシシラン、ジ エチル・ジ・n・ブトキシシラン、ジエチル・ジ・sec・ブトキシシラン、ジエチル・ ジ・tert‐ブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、ジ・n‐プロピルジメト キシシラン、ジ - n - プロピルジエトキシシラン、ジ - n - プロピル - ジ - n - プロポキ シシラン、ジ・n・プロピル・ジ・i s o - プロポキシシラン、ジ・n - プロピル・ジ・ n - ブトキシシラン、ジ・n - プロピル - ジ・s e c - ブトキシシラン、ジ・n - プロピ ル - ジ - tert - ブトキシシラン、ジ - n - プロピル - ジ - フェノキシシラン、ジ - i so-プロピルジメトキシシラン、ジ-iso-プロピルジエトキシシラン、ジ-iso - プロピル - ジ - n - プロポキシシラン、ジ - i s o - プロピル - ジ - i s o - プロポキ シシラン、ジ・iso‐プロピル・ジ・n‐ブトキシシラン、ジ・iso‐プロピル・ジ - s e c - ブトキシシラン、ジ - i s o - プロピル - ジ - t e r t - ブトキシシラン、ジ - iso-プロピル-ジ-フェノキシシラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n - ブチルジエトキシシラン、ジ - n - ブチル - ジ - n - プロポキシシラン、ジ - n - ブチ ル・ジ・iso・プロポキシシラン、ジ・n・ブチル・ジ・n・ブトキシシラン、ジ・n - ブチル - ジ - sec - ブトキシシラン、ジ - n - ブチル - ジ - tert - ブトキシシラ ン、ジ・n・ブチル・ジ・フェノキシシラン、ジ・sec・ブチルジメトキシシラン、ジ - s e c - ブチルジエトキシシラン、ジ - s e c - ブチル - ジ - n - プロポキシシラン、 ジ - sec - ブチル - ジ - i so - プロポキシシラン、ジ - sec - ブチル - ジ - n - ブ トキシシラン、ジ・sec‐ブチル‐ジ‐sec‐ブトキシシラン、ジ‐sec‐ブチル - ジ - tert - ブトキシシラン、ジ - sec - ブチル - ジ - フェノキシシラン、ジ - t ert - ブチルジメトキシシラン、ジ - tert - ブチルジエトキシシラン、ジ - ter t - ブチル - ジ - n - プロポキシシラン、ジ - t e r t - ブチル - ジ - i s o - プロポキ シシラン、ジ・tert‐ブチル‐ジ‐n‐ブトキシシラン、ジ‐tert‐ブチル‐ジ - s e c - ブトキシシラン、ジ・t e r t - ブチル・ジ・t e r t - ブトキシシラン、ジ - tert-ブチル-ジ-フェノキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニル - ジ - エトキシシラン、ジフェニル - ジ - n - プロポキシシラン、ジフェニル - ジ - i s o-プロポキシシラン、ジフェニル-ジ-n-ブトキシシラン、ジフェニル-ジ-sec - ブトキシシラン、ジフェニル - ジ - tert - ブトキシシラン、ジフェニルジフェノキ シシラン、ジビニルトリメトキシシランなど;

## [0031]

トリクロロシラン、トリブロモシラン、トリヨードシラン、トリアセトキシシラン、メ チルトリクロロシラン、エチルトリクロロシラン、n-プロピルトリクロロシラン、イソ プロピルトリクロロシラン、n - ブチルトリクロロシラン、t - ブチルトリクロロシラン 、シクロヘキシルトリクロロシラン、フェネチルトリクロロシラン、2-ノルボルニルト リクロロシラン、ビニルトリクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、メチルトリブロ モシラン、エチルトリブロモシラン、n-プロピルトリブロモシラン、イソプロピルトリ ブロモシラン、 n - ブチルトリブロモシラン、 t - ブチルトリブロモシラン、シクロヘキ シルトリブロモシラン、フェネチルトリブロモシラン、2 - ノルボルニルトリブロモシラ ン、ビニルトリブロモシラン、フェニルトリブロモシラン、メチルトリヨードシラン、エ チルトリヨードシラン、n - プロピルトリヨードシラン、イソプロピルトリヨードシラン 、n-ブチルトリヨードシラン、t-ブチルトリヨードシラン、シクロヘキシルトリヨー ドシラン、フェネチルトリヨードシラン、2-ノルボルニルトリヨードシラン、ビニルト リヨードシラン、フェニルトリヨードシラン、メチルトリアセトキシシラン、エチルトリ アセトキシシラン、 n - プロピルトリアセトキシシラン、イソプロピルトリアセトキシシ ラン、n-ブチルトリアセトキシシラン、t-ブチルトリアセトキシシラン、シクロヘキ シルトリアセトキシシラン、フェネチルトリアセトキシシラン、2-ノルボルニルトリア セトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、フェニルトリアセトキシシラン、ジメチ ルジクロロシラン、ジエチルジクロロシラン、ジ - n - プロピルジクロロシラン、ジイソ プロピルジクロロシラン、ジ - n - ブチルジクロロシラン、ジ - t - ブチルジクロロシラ

20

30

40

50

ン、ジシクロヘキシルジクロロシラン、ジフェネチルジクロロシラン、ジ・2・ノルボル ニルジクロロシラン、ジビニルジクロロシラン、ジフェニルジクロロシラン、ジメチルジ ブロモシラン、ジエチルジブロモシラン、ジ - n - プロピルジブロモシラン、ジイソプロ ピルジブロモシラン、ジ - n - ブチルジブロモシラン、ジ - t - ブチルジブロモシラン、 ジシクロヘキシルジブロモシラン、ジフェネチルジブロモシラン、ジ・2 - ノルボルニル ジブロモシラン、ジビニルジブロモシラン、ジフェニルジブロモシラン、ジメチルジヨー ドシラン、ジエチルジョードシラン、ジ・n - プロピルジョードシラン、ジイソプロピル ジョードシラン、ジ - n - ブチルジョードシラン、ジ - t - ブチルジョードシラン、ジシ クロヘキシルジョードシラン、ジフェネチルジョードシラン、ジ・2 - ノルボルニルジョ ードシラン、ジビニルジヨードシラン、ジフェニルジヨードシラン、ジメチルジアセトキ シシラン、ジエチルジアセトキシシラン、ジ・n・プロピルジアセトキシシラン、ジイソ プロピルジアセトキシシラン、ジ - n - ブチルジアセトキシシラン、ジ - t - ブチルジア セトキシシラン、ジシクロヘキシルジアセトキシシラン、ジフェネチルジアセトキシシラ ン、ジ-2-ノルボルニルジアセトキシシラン、ジビニルジアセトキシシラン、ジフェニ ルジアセトキシシラン、トリメチルクロロシラン、トリエチルクロロシラン、トリ - n -プロピルクロロシラン、トリイソプロピルクロロシラン、トリ - n - ブチルクロロシラン 、トリ・t-ブチルクロロシラン、トリシクロヘキシルクロロシラン、トリフェネチルク ロロシラン、トリ・2 - ノルボルニルクロロシラン、トリビニルクロロシラン、トリフェ ニルクロロシラン、トリメチルブロモシラン、トリエチルブロモシラン、トリ・n-プロ ピルブロモシラン、トリイソプロピルブロモシラン、トリ - n - ブチルブロモシラン、ト リ・t・ブチルブロモシラン、トリシクロヘキシルブロモシラン、トリフェネチルブロモ シラン、トリ・2・ノルボルニルブロモシラン、トリビニルブロモシラン、トリフェニル ブロモシラン、トリメチルヨードシラン、トリエチルヨードシラン、トリ - n - プロピル ヨードシラン、トリイソプロピルヨードシラン、トリ - n - ブチルヨードシラン、トリ t - ブチルヨードシラン、トリシクロヘキシルヨードシラン、トリフェネチルヨードシラ ン、トリ・2・ノルボルニルヨードシラン、トリビニルヨードシラン、トリフェニルヨー ドシラン、トリメチルアセトキシシラン、トリエチルアセトキシシラン、トリ・n - プロ ピルアセトキシシラン、トリイソプロピルアセトキシシラン、トリ - n - ブチルアセトキ シシラン、トリ・t・ブチルアセトキシシラン、トリシクロヘキシルアセトキシシラン、 トリフェネチルアセトキシシラン、トリ・2・ノルボルニルアセトキシシラン、トリビニ ルアセトキシシラン、トリフェニルアセトキシシランなどのケイ素化合物を挙げることが できる。これらの化合物は1種単独でも使用できるし、2種以上を混合して使用すること もできる。

## [0032]

化合物 1 としては、好ましくは、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ・n・プロポキシシラン、メチルトリ・iso・プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジスチルジエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

[0033]

1 . 2 . 一般式(2)で表される化合物(以下、「化合物2」ともいう)

ー般式(2)において、 $R^{-1}$ , $R^{-2}$ で表される1価の有機基としては、先の一般式(1)で表される化合物においてRとして例示した有機基と同じものを挙げることができる。

一般式(2)のうち、R $^3$ が酸素原子の化合物としては、ヘキサクロロジシロキサン、ヘキサプロモジシロキサン、ヘキサヨードシジシロキサン、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタフェノキシ-3-メチルジシロキサン、1,1,1,3,3-ペンタフェノキシ-3-メチルジシロキサン

20

30

40

50

、 1 , 1 , 1 , 3 , 3 - ペンタメトキシ - 3 - エチルジシロキサン、 1 , 1 , 1 , 3 , 3 ペンタエトキシ - 3 - エチルジシロキサン、1 , 1 , 1 , 3 , 3 - ペンタフェノキシ -3 - エチルジシロキサン、1,1,1,3,3 - ペンタメトキシ - 3 - フェニルジシロキ サン、1,1,1,3,3-ペンタエトキシ-3-フェニルジシロキサン、1,1,1, 3 , 3 - ペンタフェノキシ - 3 - フェニルジシロキサン、1 , 1 , 3 , 3 - テトラメトキ シ・1,3-ジメチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシ・1,3-ジメチ ルジシロキサン、1,1,3,3-テトラフェノキシ-1,3-ジメチルジシロキサン、 1 , 1 , 3 , 3 - テトラメトキシ - 1 , 3 - ジエチルジシロキサン、 1 , 1 , 3 , 3 - テ トラエトキシ・1,3-ジエチルジシロキサン、1,1,3,3-テトラフェノキシ・1 , 3 - ジエチルジシロキサン、1 , 1 , 3 , 3 - テトラメトキシ - 1 , 3 - ジフェニルジ シロキサン、1,1,3,3-テトラエトキシ-1,3-ジフェニルジシロキサン、1, 1 , 3 , 3 - テトラフェノキシ - 1 , 3 - ジフェニルジシロキサン、 1 , 1 , 3 - トリメ トキシ - 1 , 3 , 3 - トリメチルジシロキサン、1 , 1 , 3 - トリエトキシ - 1 , 3 , 3 - トリメチルジシロキサン、 1 , 1 , 3 - トリフェノキシ - 1 , 3 , 3 - トリメチルジシ ロキサン、1,1,3-トリメトキシ-1,3,3-トリエチルジシロキサン、1,1, 3 - トリエトキシ - 1 , 3 , 3 - トリエチルジシロキサン、1 , 1 , 3 - トリフェノキシ - 1 , 3 , 3 - トリエチルジシロキサン、1 , 1 , 3 - トリメトキシ - 1 , 3 , 3 - トリ フェニルジシロキサン、1,1,3-トリエトキシ-1,3,3-トリフェニルジシロキ サン、1,1,3-トリフェノキシ-1,3,3-トリフェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ・1 , 1 , 3 , 3 - テトラメチルジシロキサン、1 , 3 - ジエトキシ・1 , 1 , 3 , 3 - テトラメチルジシロキサン、1 , 3 - ジフェノキシ - 1 , 1 , 3 , 3 - テトラ メチルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3,3-テトラエチルジシロキサン 、 1 , 3 - ジエトキシ - 1 , 1 , 3 , 3 - テトラエチルジシロキサン、 1 , 3 - ジフェノ キシ - 1 , 1 , 3 , 3 - テトラエチルジシロキサン、1 , 3 - ジメトキシ - 1 , 1 , 3 , 3 - テトラフェニルジシロキサン、1 , 3 - ジエトキシ - 1 , 1 , 3 , 3 - テトラフェニ ルジシロキサン、1,3-ジフェノキシ-1,1,3,3-テトラフェニルジシロキサン などを挙げることができる。

[0034]

これらのうち、ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 3-ジメトキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 1-ジェニルジシロキサン。1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スープロ・1-スー

[0035]

また、一般式(2)において、 d が 0 の化合物としては、ヘキサクロロジシラン、ヘキサプロモジシラン、ヘキサヨードシジシラン、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキシジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタメトキシ - 2 - メチルジシラン、1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタフェノキシ - 2 - メチルジシラン、1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタメトキシ - 2 - エチルジシラン、1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタメトキシ - 2 - エチルジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタメトキシ - 2 - エチルジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタフェノキシ - 2 - エチルジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタエトキシ - 2 - フェニルジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - ペンタエトキシ - 2 - フェニルジシラン、1 , 1 , 1 , 2 , 2 - アトラエトキシ - 2 , 2 - アトラメトキシ - 1 , 2 - ジメチルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラエトキシ - 1 , 2 - ジメチルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェノキシ - 1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェノキシ - 1 , 2 - ジエチルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェノキシ - 1 , 2 - ジエチルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェノキシ - 1 , 2 - ジフェニルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェノキシ - 1 , 2 - ジエチルジシラン、1 , 1 , 2 , 2 - アトラフェニルジシラ

20

30

40

50

ン、1,1,2,2-テトラエトキシ-1,2-ジフェニルジシラン、1,1,2,2-テトラフェノキシ - 1 , 2 - ジフェニルジシラン、1 , 1 , 2 - トリメトキシ - 1 , 2 , 2 - トリメチルジシラン、 1 , 1 , 2 - トリエトキシ - 1 , 2 , 2 - トリメチルジシラン 、 1 , 1 , 2 - トリフェノキシ - 1 , 2 , 2 - トリメチルジシラン、 1 , 1 , 2 - トリメ トキシ・1,2,2-トリエチルジシラン、1,1,2-トリエトキシ・1,2,2-ト リエチルジシラン、1,1,2-トリフェノキシ-1,2,2-トリエチルジシラン、1 , 1 , 2 - トリメトキシ - 1 , 2 , 2 - トリフェニルジシラン、 1 , 1 , 2 - トリエトキ シ-1,2,2-トリフェニルジシラン、1,1,2-トリフェノキシ-1,2,2-ト リフェニルジシラン、 1 , 2 - ジメトキシ - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラメチルジシラン、 1 , 2 - ジエトキシ - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラメチルジシラン、 1 , 2 - ジフェノキシ - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラメチルジシラン、1 , 2 - ジメトキシ - 1 , 1 , 2 , 2 - テトラエ チルジシラン、1,2-ジエトキシ-1,1,2,2-テトラエチルジシラン、1,2-ジフェノキシ・1,1,2,2.テトラエチルジシラン、1,2.ジメトキシ・1,1, 2,2-テトラフェニルジシラン、1,2-ジエトキシ-1,1,2,2-テトラフェニ ルジシラン、1,2‐ジフェノキシ‐1,1,2,2‐テトラフェニルジシランなどを挙 げることができる。

### [0036]

### [0037]

さらに、一般式(2)において、R $^3$ が-(CH $_2$ )。-で表される基の化合物として は、ビス(トリクロロシリル)メタン、ビス(トリブロモシリル)メタン、ビス(トリヨ ードシリル)メタン、ビス(トリクロロシリル)エタン、ビス(トリブロモシリル)エタ ン、ビス(トリヨードシリル)エタン、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリ エトキシシリル)メタン、ビス(トリ - n - プロポキシシリル)メタン、ビス(トリ - i - プロポキシシリル)メタン、ビス(トリ-n-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリsec-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリ-t-ブトキシシリル)メタン、1,2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エタン、1, 2 - ビス(トリ・n - プロポキシシリル)エタン、1、2 - ビス(トリ・i - プロポキシ シリル)エタン、1,2-ビス(トリ-n-1、プトキシシリル)エタン、1,2-ビス (トリ・sec-ブトキシシリル)エタン、1、1,2、2-ビス(トリ・t-ブトキシ シリル)エタン、1 - (ジメトキシメチルシリル) - 1 - (トリメトキシシリル)メタン 、1 - (ジエトキシメチルシリル) - 1 - (トリエトキシシリル)メタン、1 - (ジ - n - プロポキシメチルシリル) - 1 - (トリ - n - プロポキシシリル)メタン、1 - (ジ i‐プロポキシメチルシリル)‐1‐(トリ‐i‐プロポキシシリル)メタン、1‐(ジ - n - ブトキシメチルシリル) - 1 - (トリ - n - ブトキシシリル)メタン、1 - (ジ sec-ブトキシメチルシリル) - 1 - (トリ-sec-ブトキシシリル)メタン、1 -(ジ・t・ブトキシメチルシリル)・1 - (トリ・t・ブトキシシリル)メタン、1 - ( ジメトキシメチルシリル) - 2 - (トリメトキシシリル)エタン、1 - (ジエトキシメチ ルシリル) - 2 - (トリエトキシシリル)エタン、1 - (ジ - n - プロポキシメチルシリ ル) - 2 - (トリ・n - プロポキシシリル) エタン、1 - (ジ・i - プロポキシメチルシ リル) - 2 - (トリ・i - プロポキシシリル)エタン、1 - (ジ - n - ブトキシメチルシ リル) - 2 - (トリ - n - ブトキシシリル) エタン、1 - (ジ - s e c - ブトキシメチル シリル) - 2 - (トリ・sec - ブトキシシリル)エタン、1 - (ジ・t・ブトキシメチ ルシリル) - 2 - (トリ・t - ブトキシシリル) エタン、ビス(ジメトキシメチルシリル

20

30

50

) メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス(ジ - n - プロポキシメチルシ リル)メタン、ビス(ジ・i - プロポキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ・n - ブトキ シメチルシリル)メタン、ビス(ジ・sec・ブトキシメチルシリル)メタン、ビス(ジ - t - ブトキシメチルシリル)メタン、1,2-ビス(ジメトキシメチルシリル)エタン 、1,2-ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、1,2-ビス(ジ-n-プロポキシ メチルシリル)エタン、1,2-ビス(ジ・i-プロポキシメチルシリル)エタン、1, 2 - ビス(ジ-n-ブトキシメチルシリル)エタン、1,2 - ビス(ジ-sec-ブトキ シメチルシリル)エタン、1,2-ビス(ジ-t-ブトキシメチルシリル)エタン、1, 2 - ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1 ,2 - ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1,2-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、1,2-ビス(トリ-n-ブトキシシリル)ベンゼン、1 , 2 - ビス ( トリ - s e c - ブトキシシリル ) ベンゼン、 1 , 2 - ビス ( トリ - t - ブト キシシリル)ベンゼン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1,3-ビス( トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン 1 , 3 - ビス(トリ - i - プロポキシシリル)ベンゼン、1 , 3 - ビス(トリ - n - ブ トキシシリル)ベンゼン、1,3-ビス(トリ-sec-ブトキシシリル)ベンゼン、1 , 3 - ビス(トリ - t - ブトキシシリル)ベンゼン、1 , 4 - ビス(トリメトキシシリル ) ベンゼン、1,4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,4-ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1,4-ビス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、 1 , 4 - ビス(トリ - n - ブトキシシリル)ベンゼン、1 , 4 - ビス(トリ - s e c - ブ トキシシリル)ベンゼン、1,4-ビス(トリ-t-ブトキシシリル)ベンゼンなど挙げ ることができる。

[0038]

これらのうち、ビス(トリメトキシシリル)メタン、ビス(トリエトキシシリル)メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル))-1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル)エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリエトキシシリル)エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)エタン、ビス(ジメトキシメチルシリル)エタン、ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(ジエトキシメチルシリル)エタン、1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 1-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼンなどを好ましい例として挙げることができる。

[0039]

化合物1,2としては、1種もしくは2種以上を用いることができる。

[0040]

2. 環状シランモノマー

環状シランモノマーとしては、前記一般式(3)で表される化合物の群から選ばれた少 40 なくとも 1 種の環状シランモノマーであることができる。

[0041]

2 . 1 . 一般式(3)で表される化合物(以下、「化合物3」ともいう)

化合物 3 としては、 1 、 1 ・ ジメチル・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジクロロ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジプロモ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジヨード・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジアセトキシ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジメトキシ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジエトキシ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジメトキシ・シラシクロブタン、 1 、 1 ・ ジジメチル・シラシクロペンタン、 1 、 1 ・ ジメトキシ・シラシクロペンタン、 1 、 1 ・ ジエトキシ・シラシクロペンタン、 1 、 1 ・ ジイソプロポキシ・シラシクロペンタン、 1 、 1 、 3 、 3 ・ テトラメチル・ 1 、 3 ・ ジシラシクロブタン、 1 、 1 、 3 、

20

30

40

50

3 - テトラクロロ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、1 , 1 , 3 , 3 - テトラブロモ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、1,1,3,3 - テトラヨード - 1,3 - ジシラシクロブタン 、 1 , 1 , 3 , 3 - テトラアセトキシ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、 1 , 1 , 3 , 3 -テトラメトキシ・1,3-ジシラシクロブタン、1,1,3,3-テトラエトキシ・1, 3 - ジシラシクロブタン、1 , 1 , 3 , 3 - テトライソプロポキシ - 1 , 3 - ジシラシク ロブタン、1,3-ジメチル-1,3-ジクロロ-1,3-ジシラシクロブタン、1,3 - ジメチル - 1 , 3 - ジブロモ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジョード - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジアセトキシ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジメトキシ - 1 , 3 - ジシ ラシクロブタン、1,3‐ジメチル‐1,3‐ジエトキシ‐1,3‐ジシラシクロブタン 、 1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジイソプロポキシ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン、 1 , 1 . 3 . 3 . 5 . 5 - ヘキサメチル - 1 . 3 . 5 - トリシラシクロヘキサン、 1 . 1 . 3 . 3 , 5 , 5 - ヘキサクロロ - 1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン、 1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 - ヘキサプロモ - 1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン、 1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 -ヘキサヨード・1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン、1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 - ヘキサ アセトキシ・1,3,5-トリシラシクロヘキサン、1,1,3,3,5,5-ヘキサメ トキシ・1,3,5-トリシラシクロヘキサン、1,1,3,3,5,5-ヘキサエトキ シ - 1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン、 1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 - ヘキサエトキシ -1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン、1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 - ヘキサイソプロポキシ - 1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサンなどを挙げることができる。これらの環状シラン モノマーは、1種もしくは2種以上を用いることができる。

[0042]

3.ポリマーの製造方法

本発明のポリマーは、例えば、化合物 1 , 2 の群から選ばれた少なくとも 1 種のシラン 化合物と、化合物 3 の群から選ばれた少なくとも 1 種の環状シランモノマーとを、有機溶 媒中で混合し、加熱することにより、化合物 1 ~ 3 が加水分解,縮合して得られる。

[0043]

化合物 1 , 2 の群から選ばれた少なくとも 1 種のシラン化合物と、化合物 3 の群から選ばれた少なくとも 1 種の環状シランモノマーとを混合、加熱する際に、化合物 1 , 2 の 1 モル当たり 0 . 5 モルを越え 1 5 0 モル以下の水を用いることが好ましく、 0 . 5 モルを越え 1 3 0 モル以下の水を加えることが特に好ましい。

[0044]

本発明のポリマーを製造するに際しては、化合物 1 , 2 の群から選ばれた少なくとも 1 種のシラン化合物と、化合物 3 の群から選ばれた少なくとも 1 種の環状シランモノマーとを加水分解,縮合させる際に、特定の触媒を用いることができる。触媒としては、塩基性触媒、金属キレート触媒、酸触媒の群から選ばれる少なくとも 1 種を使用することができる。

[0045]

3.1. 塩基性触媒

本発明の一実施形態に係るポリマーの製造において、(C)塩基性触媒の存在下で(A)成分および(B)成分を共縮合することにより、得られるポリマーの分子構造に存在する分子鎖の分岐度を高くすることができ、かつ、その分子量をより大きくすることができる。これにより、上述した構造を有するポリマーを得ることができる。

[0046]

塩基性触媒としては、例えば、メタノールアミン、エタノールアミン、プロパノールアミン、ブタノールアミン、N-メチルメタノールアミン、N-エチルメタノールアミン、N-プロピルメタノールアミン、N-ブチルエタノールアミン、N-エチルエタノールアミン、N-ブロピルエタノールアミン、N-ブチルエタノールアミン、N-メチルプロパノールアミン、N-プロピルプロパノールアミン、N-ブチルプロパノールアミン、N-ブチルプロパノールアミン、N-メチルブタノールアミン

20

30

40

50

、N-エチルブタノールアミン、N-プロピルブタノールアミン、N-ブチルブタノール アミン、N , N - ジメチルメタノールアミン、N , N - ジエチルメタノールアミン、N , N -  $\vec{y}$   $\vec{J}$   $\vec{U}$   $\vec{U}$   $\vec{V}$   $\vec{V}$   $\vec{J}$   $\vec$ ルエタノールアミン、N,N-ジエチルエタノールアミン、N,N-ジプロピルエタノー ルアミン、N,N-ジブチルエタノールアミン、N,N-ジメチルプロパノールアミン、 N, N-ジエチルプロパノールアミン、N, N-ジプロピルプロパノールアミン、N, N - ジブチルプロパノールアミン、N , N - ジメチルブタノールアミン、N , N - ジエチル ブタノールアミン、N,N-ジプロピルブタノールアミン、N,N-ジブチルブタノール アミン、N - メチルジメタノールアミン、N - エチルジメタノールアミン、N - プロピル ジメタノールアミン、N-ブチルジメタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、 N - エチルジエタノールアミン、N - プロピルジエタノールアミン、N - ブチルジエタノ ールアミン、N - メチルジプロパノールアミン、N - エチルジプロパノールアミン、N -プロピルジプロパノールアミン、N - ブチルジプロパノールアミン、N - メチルジブタノ ールアミン、N-エチルジブタノールアミン、N-プロピルジブタノールアミン、N-ブ チルジブタノールアミン、N - (アミノメチル)メタノールアミン、N - (アミノメチル ) エタノールアミン、N - (アミノメチル)プロパノールアミン、N - (アミノメチル) ブタノールアミン、N - (アミノエチル)メタノールアミン、N - (アミノエチル)エタ ノールアミン、N - (アミノエチル)プロパノールアミン、N - (アミノエチル)ブタノ ールアミン、N - (アミノプロピル)メタノールアミン、N - (アミノプロピル)エタノ ールアミン、N - (アミノプロピル)プロパノールアミン、N - (アミノプロピル)ブタ ノールアミン、N - (アミノブチル)メタノールアミン、N - (アミノブチル)エタノー ルアミン、N - (アミノブチル)プロパノールアミン、N - (アミノブチル)ブタノール アミン、メトキシメチルアミン、メトキシエチルアミン、メトキシプロピルアミン、メト キシブチルアミン、エトキシメチルアミン、エトキシエチルアミン、エトキシプロピルア ミン、エトキシブチルアミン、プロポキシメチルアミン、プロポキシエチルアミン、プロ ポキシプロピルアミン、プロポキシブチルアミン、ブトキシメチルアミン、ブトキシエチ ルアミン、ブトキシプロピルアミン、ブトキシブチルアミン、メチルアミン、エチルアミ ン、プロピルアミン、ブチルアミン、N ,N -ジメチルアミン、N ,N -ジエチルアミン 、N,N-ジプロピルアミン、N,N-ジブチルアミン、トリメチルアミン、トリエチル アミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、テトラメチルアンモニウムハイドロキ サイド、テトラエチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラプロピルアンモニウムハイ ドロキサイド、テトラブチルアンモニウムハイドロキサイド、テトラメチルエチレンジア ミン、テトラエチルエチレンジアミン、テトラプロピルエチレンジアミン、テトラブチル エチレンジアミン、メチルアミノメチルアミン、メチルアミノエチルアミン、メチルアミ ノプロピルアミン、メチルアミノブチルアミン、エチルアミノメチルアミン、エチルアミ ノエチルアミン、エチルアミノプロピルアミン、エチルアミノブチルアミン、プロピルア ミノメチルアミン、プロピルアミノエチルアミン、プロピルアミノプロピルアミン、プロ ピルアミノブチルアミン、ブチルアミノメチルアミン、ブチルアミノエチルアミン、ブチ ルアミノプロピルアミン、ブチルアミノブチルアミン、ピリジン、ピロール、ピペラジン 、ピロリジン、ピペリジン、ピコリン、モルホリン、メチルモルホリン、ジアザビシクロ オクラン、ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウンデセン、アンモニア、水酸化ナト リウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム、水酸化カルシウムなどを挙げることができる

# [0047]

塩基性触媒としては、特に、下記一般式(4)で表される含窒素化合物(以下、「化合物4」ともいう。)であることが好ましい。

 $(X 1 X 2 X 3 X 4 N)_f Y \cdots (4)$ 

前記一般式(4)において、X1, X2, X3, X4は同一または異なり、それぞれ水素原子、炭素数  $1 \sim 20$ のアルキル基(好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基など)、ヒドロキシアルキル基(好ましくはヒドロキシエチル基など

20

30

40

50

)、アリール基(好ましくはフェニル基など)、アリールアルキル基(好ましくはフェニルメチル基など)を示し、Yはハロゲン原子(好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など)、1~4価のアニオン性基(好ましくはヒドロキシ基など)を示し、fは1~4の整数を示す。

## [0048]

化合物 4 の具体例としては、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルア ンモニウム、水酸化テトラ・n-プロピルアンモニウム、水酸化テトラ-iso-プロピ ルアンモニウム、水酸化テトラ - n - ブチルアンモニウム、水酸化テトラ - i s o - ブチ ルアンモニウム、水酸化テトラ・tert - ブチルアンモニウム、水酸化テトラペンチル アンモニウム、水酸化テトラヘキシルアンモニウム、水酸化テトラヘプチルアンモニウム 、水酸化テトラオクチルアンモニウム、水酸化テトラノニルアンモニウム、水酸化テトラ デシルアンモニウム、水酸化テトラウンデシルアンモニウム、水酸化テトラドデシルアン モニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメチルアンモニウム、臭化テトラ エチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラ - n - プロピルアンモ ニウム、塩化テトラ・n - プロピルアンモニウム、臭化テトラ・n - ブチルアンモニウム 、塩化テトラ-n-ブチルアンモニウム、水酸化ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、 臭化 - n - ヘキサデシルトリメチルアンモニウム、水酸化 - n - オクタデシルトリメチル アンモニウム、臭化 - n - オクタデシルトリメチルアンモニウム、塩化セチルトリメチル アンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンジルトリメチルアンモ ニウム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、 塩化トリデシルメチルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムハイドロジェンサルフェ ート、臭化トリプチルメチルアンモニウム、塩化トリオクチルメチルアンモニウム、塩化 トリラウリルメチルアンモニウム、水酸化ベンジルトリメチルアンモニウム、臭化ベンジ ルトリエチルアンモニウム、臭化ベンジルトリブチルアンモニウム、臭化フェニルトリメ チルアンモニウム、コリン等を好ましい例として挙げることができる。これらのうち特に 好ましくは、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水酸 化テトラ・n - プロピルアンモニウム、水酸化テトラ・n - ブチルアンモニウム、臭化テ トラメチルアンモニウム、塩化テトラメチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウ ム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラ - n - プロピルアンモニウム、塩化テト ラ - n - プロピルアンモニウムである。化合物 4 は、 1 種あるいは 2 種以上を同時に使用 してもよい。

# [0049]

### 3 . 2 . 金属キレート触媒

金属キレート触媒としては、例えば、トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チ タン、トリ - n - プロポキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、トリ - i - プロポ キシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、トリ・n - ブトキシ・モノ(アセチルアセ トナート)チタン、トリ-sec-ブトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ト リ - t - ブトキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタン、ジエトキシ・ビス(アセチル アセトナート)チタン、ジ - n - プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、ジ - i - プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、ジ - n - ブトキシ・ビス(ア セチルアセトナート)チタン、ジ - s e c - ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チ タン、ジ・t - ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート)チタン、モノ - n - プロポキシ・トリス(アセチルアセトナー ト)チタン、モノ - i - プロポキシ・トリス(アセチルアセトナート)チタン、モノ - n - ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ - s e c - ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート)チタン、モノ·t·ブトキシ・トリス(アセチルアセトナート ) チタン、テトラキス(アセチルアセトナート)チタン、トリエトキシ・モノ(エチルア セトアセテート)チタン、トリ・n - プロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタ ン、トリ-i-プロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリ-n-ブトキ シ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリ・sec‐ブトキシ・モノ(エチルア

20

30

40

50

セトアセテート)チタン、トリ・ t - ブトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、ジェトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジェ n - プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジェ n - プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジェ n - ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジェ n - ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、ジェ n - ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)チタン、モノエトキシ・トリス(エチルアセトアセテート)チタン、モノ・n - プロポキシ・トリス(エチルアセトアセテート)チタン、モノ・n - ブトキシ・トリス(エチルアセトアセテート)チタン、モノ・n - ブトキシ・トリス(エチルアセトアセテート)チタン、アセトアセテート)チタン、アセトアセテート)チタン、アセトリス(エチルアセトアセテート)チタン、アセトアセテート)チタン、モノ(アセチルアセトナート)トリス(エチルアセトアセテート)チタン、ビス(アセチルアセトナート)ビス(エチルアセトアセテート)チタンなどのチタンキレート化合物;

## [0050]

トリエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ - n - プロポキシ・ モノ(アセチルアセトナート)ジルコニウム、トリ・i - プロポキシ・モノ(アセチルア セトナート)ジルコニウム、トリ·n·ブトキシ・モノ(アセチルアセトナート)ジルコ ニウム、トリ-sec-ブトキシ・モノ(アセチルアセトナート)ジルコニウム、トリt - ブトキシ・モノ(アセチルアセトナート)ジルコニウム、ジエトキシ・ビス(アセチ ルアセトナート)ジルコニウム、ジ - n - プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)ジ ルコニウム、ジ · i · プロポキシ・ビス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、ジ · n - ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジ - sec - ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート)ジルコニウム、ジ・t - ブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト)ジルコニウム、モノエトキシ・トリス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、モノ - n - プロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノ - i - プロポキ シ・トリス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、モノ・n・ブトキシ・トリス(アセ チルアセトナート)ジルコニウム、モノ - sec - ブトキシ・トリス(アセチルアセトナ ート)ジルコニウム、モノ・t・ブトキシ・トリス(アセチルアセトナート)ジルコニウ ム、テトラキス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、トリエトキシ・モノ(エチルア セトアセテート)ジルコニウム、トリ・n・プロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート ) ジルコニウム、トリ・i - プロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート) ジルコニウム 、トリ・n-ブトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリ・sec-ブトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリ・t・ブトキシ・モノ( エチルアセトアセテート)ジルコニウム、ジエトキシ・ビス(エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジ・n - プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、ジ - i - プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、ジ - n - ブトキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジ・sec - ブトキシ・ビス (エチルア セトアセテート)ジルコニウム、ジ・t・ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテート)ジ ルコニウム、モノエトキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ - n プロポキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ・i・プロポキシ ・トリス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ - n - ブトキシ・トリス(エチ ルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ・sec - ブトキシ・トリス(エチルアセトア セテート)ジルコニウム、モノ・t・ブトキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジル コニウム、テトラキス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノ(アセチルアセト ナート)トリス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、ビス(アセチルアセトナート )ビス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリス(アセチルアセトナート)モノ (エチルアセトアセテート)ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物;

トリス(アセチルアセトナート)アルミニウム、トリス(エチルアセトアセテート)アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合物;

などを挙げることができ、好ましくはチタンまたはアルミニウムのキレート化合物、特に 好ましくはチタンのキレート化合物を挙げることができる。これらの金属キレート触媒は 、1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

### [0051]

### 3 . 3 . 酸触媒媒

酸触媒としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸などの無機酸:

酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、2・エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p・アミノ安息香酸、p・トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸、コハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラコン酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解物、無水マレイン酸の加水分解物、無水フタル酸の加水分解物などの有機酸を挙げることができ、有機カルボン酸をより好ましい例として挙げることができる。これらの酸触媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

### [0052]

前記触媒は、単独であるいは2種以上を同時に使用してもよい。また、前記触媒の使用量は、化合物1,2中の加水分解性基X,Y,Zで表される基および化合物3の置換基R4、R5、R6、R7中の加水分解性基の総量1モルに対して、通常、0.00001~10モル、好ましくは0.0005~5モルである。触媒の使用量が前記範囲内であれば、反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。また、本発明において、化合物1,2を加水分解するときの温度は、通常0~100 、好ましくは15~80 である。本発明において、環状シランモノマー(化合物3)に対する化合物1,2の使用量は、環状シランモノマー100重量部に対して化合物1,2の総量成分が10~4000重量部、より好ましくは1000~3000重量部である。使用量がこの範囲であると、塗布膜の機械的強度の向上が効果的に発現する。

## [0053]

## 4.ポリマー膜形成組成物

本発明のポリマー膜形成用組成物(以下、「膜形成用組成物」という)には、本発明のポリマーに加え、さらに - ジケトン、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活性剤、シランカップリング剤、ラジカル発生剤などの成分を添加してもよい。本発明のポリマー膜形成用組成物は例えば、絶縁膜形成用組成物として用いることができる。

## [0054]

- ジケトンとしては、アセチルアセトン、2 , 4 - ヘキサンジオン、2 , 4 - ヘプタンジオン、3 , 5 - ヘプタンジオン、2 , 4 - オクタンジオン、3 , 5 - オクタンジオン、2 , 4 - ノナンジオン、3 , 5 - オクタンジオン、5 - メチル - 2 , 4 - ヘキサンジオン、2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 3 , 5 - ヘプタンジオン、1 , 1 , 1 , 5 , 5 , 5 - ヘキサフルオロ - 2 , 4 - ヘプタンジオンなどを挙げることができ、より好ましくはアセチルアセトン、2 , 4 - ヘキサンジオン、2 , 4 - ヘプタンジオン、3 , 5 - ヘプタンジオンである。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

# [0055]

コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30nm、好ましくは10~20nm、固形分濃度が10~40重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。

# [0056]

50

10

20

30

20

30

40

50

コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル 5 2 0 、同 1 0 0 、同 2 0 0 ; 川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 1 0 、同 1 3 2 などが挙げられる。

### [0057]

有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ)アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、デンドリマー、ポリイミド,ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール、フッ素系重合体、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物などを挙げることができる。

### [0058]

ポリアルキレンオキサイド構造を有する化合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチレンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキシド構造などが挙げられる。

### [0059]

具体的には、ポリオキシメチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオキシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなどのエーテル型化合物、ポリオ・シエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンリルビタン脂肪酸アルカノールアミド硫酸塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型化合物などを挙げることができる。

## [0060]

ポリオキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマーとしては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙げられる。

### [0061]

- (X')j-(Y')k-

- (X') j - (Y') k - (X') 1 -

(式中、X 'は - C H  $_2$  C H  $_2$  O - で表される基を、Y 'は - C H  $_2$  C H (C H  $_3$ ) O - で表される基を示し、j は 1 ~ 9 0、k は 1 0 ~ 9 9、l は 0 ~ 9 0の数を示す。)

これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシ プロピレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエー テル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合 物をより好ましい例として挙げることができる。これらは 1 種あるいは 2 種以上を同時に 使用しても良い。

## [0062]

界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げることができる。

### [0063]

フッ素系界面活性剤としては、例えば1,1,2,2-テトラフロロオクチル(1,1,2,2-テトラフロロプロピル)エーテル、1,1,2,2-テトラフロロオクチルへキシルエーテル、オクタエチレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロロブチル)エーテル、ヘキサエチレングリコール(1,1,2,2,3-ス+サフロロペンチル)エーテル、オクタプロピレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロロブチル)エ

20

30

40

50

ーテル、ヘキサプロピレングリコールジ(1,1,2,2,3,3 - ヘキサフロロペンチル)エーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、1,1,2,2,8,8,9,10,10 - デカフロロドデカン、1,1,2,2,3,3 - ヘキサフロロデカン、N - [3 - (パーフルオロオクタンスルホンアミド)プロピル] - N,N ' - ジメチル - N - カルボキシメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアルキル - N - エチルスルホニルグリシン塩、リン酸ビス(N - パーフルオロオクチルスルホニル・N - エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活性剤を挙げることができる。

[0064]

また、市販品としてはメガファックF142D、同F172、同F173、同F183(以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフトップEF301、同303、同352(新秋田化成(株)製)、フロラードFC-430、同FC-431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、同SB-101、同SB-102、同SB-103、同SB-104、同SB-105、同SB-106(旭硝子(株)製)、BM-1000、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、前記メガファックF172,BM-1000,BM-1100,NBX-15が特に好ましい。

[0065]

シリコーン系界面活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、SH30PA、ST94PA(いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。これらの中でも、前記SH28PA、SH30PAが特に好ましい。

[0066]

界面活性剤の使用量は、本発明のポリマー(完全加水分解縮合物)に対して通常 0.0 001~10重量部である。これらは 1種あるいは 2種以上を同時に使用しても良い。

[0067]

シランカップリング剤としては、例えば3-グリシジロキシプロピルトリメトキシシラ ン、3-アミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピ ルトリメトキシシラン、3-グリシジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタ クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、 3 - アミノプロピルトリエトキシシラン、2 - アミノプロピルトリメトキシシラン、2 -アミノプロピルトリエトキシシラン、N - (2 - アミノエチル) - 3 - アミノプロピルト リメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシ ラン、3-ウレイドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシシ ラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-エトキシ カルボニル・3・アミノプロピルトリエトキシシラン、N・トリエトキシシリルプロピル トリエチレントリアミン、N-トリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、1 0 - トリメトキシシリル - 1 , 4 , 7 - トリアザデカン、10 - トリエトキシシリル - 1 , 4 , 7 - トリアザデカン、 9 - トリメトキシシリル - 3 , 6 - ジアザノニルアセテート 、 9 - トリエトキシシリル - 3 , 6 - ジアザノニルアセテート、N - ベンジル - 3 - アミ ノプロピルトリメトキシシラン、N‐ベンジル‐3‐アミノプロピルトリエトキシシラン N - フェニル - 3 - アミノプロピルトリメトキシシラン、N - フェニル - 3 - アミノプ ロピルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N - ビス(オキシエチレン) - 3 - アミノプロピルトリエトキシシランなど が挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

[0068]

ラジカル発生剤としては、例えばイソブチリルパーオキサイド、 、 '-ビス(ネオデカノイルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシネオデカノエート、

20

30

40

50

ジ - n プロピルパーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1 , 1 , 3 , 3 - テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート、ビス(4 - t - ブチル シクロヘキシル)パーオキシジカーボネート、1 - シクロヘキシル - 1 - メチルエチルパ ーオキシネオデカノエート、ジ・2・エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2 - エチルヘキシルパーオキシ)ジカーボネート、 t - ヘキシルパーオキシネオデカノエー ト、ジメトキブチルパーオキシジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチルパ ーオキシ)ジカーボネート、t - ブチルパーオキシネオデカノエート、2,4 - ジクロロベ ンゾイルパーオキサイド、t‐ヘキシルパーオキシピバレート、t‐ブチルパーオキシピ バレート、3,5,5 - トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオ キサイド、ラウロイルパーオキサイド、ステアロイルパーオキサイド、1,1,3,3 - テ トラメチルブチルパーオキシ2・エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサイド、 2.5-ジメチル-2.5-ジ(2-エチルヘキサノイルパーオキシ)ヘキサン、1-シクロ ヘキシル・1・メチルエチルパーオキシ2・エチルヘキサノエート、t・ヘキシルパーオ キシ2-エチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、t‐ブチルパ ーオキシイソブチレート、ジ・t - ブチルパーオキシ・2 - メチルシクロヘキサン、1, 1 - ビス(t - ヘキシルパーオキシ) - 3,3,5 - トリメチルシクロヘキサン、1,1 - ビ ス(t - ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1 - ビス(t - ブチルパーオキシ) - 3, 3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン 、 2 , 2 - ビス(4 , 4 - ジ - t - ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、 1 , 1 -ビス(t - ブチルパーオキシ)シクロデカン、t - ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカ ーボネート、t‐ブチルパーオキシマレイン酸、t‐ブチルパーオキシ‐3,3,5‐トリ メチルヘキサノエート、t‐ブチルパーオキシラウレート、2,5‐ジメチル・2,5‐ジ (m - トルオイルパーオキシ)ヘキサン、 t - ブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネ ート、t‐ブチルパーオキシ2‐エチルヘキシルモノカーボネート、t‐ヘキシルパーオ キシベンゾエート、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタン、t-ブチル パーオキシベンゾエート、n - ブチル - 4 , 4 - ビス(t - ブチルパーオキシ)バレレート 、ジ・t‐ブチルパーオキシイソフタレート、 、 '‐ビス(t‐ブチルパーオキシ)ジ イソプロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブ チルパーオキシ)ヘキサン、t‐ブチルクミルパーオキサイド、ジ‐t‐ブチルパーオキ サイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチル パーオキシ)ヘキシン・3、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオキサイド、t・ブチル トリメチルシリルパーオキサイド、1,1,3,3-テトラメチルブチルヒドロパーオキ サイド、クメンヒドロパーオキサイド、 t - ヘキシルヒドロパーオキサイド、 t - ブチル ヒドロパーオキサイド、2,3-ジメチル-2,3-ジフェニルブタン等を挙げることがで きる。ラジカル発生剤の配合量は、ポリマー(完全加水分解縮合物)100重量部に対し 、0.1~10重量部が好ましい。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良 ll.

[0069]

本発明の膜形成用組成物では、ポリマー(加水分解縮合物)および必要に応じて用いられる上記添加剤を溶媒に溶解あるいは分散してなる。

## [0070]

この際使用できる溶媒としては、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロトン系溶媒の群から選ばれた少なくとも 1 種が挙げられる。

# [0071]

ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、エタノール、n - プロパノール、i - プロパノール、n - ブタノール、i - ブタノール、s e c - ブタノール、t - ブタノール、i - ペンタノール、i - ペンタノール・i - ペンタノール、i - ペンタノール、i - ペンタノール、i - ペンタノール・i - ペンタノール、i - ペンタノール・i - ペンタイル・i - ペンタイル・i - ペンタイル・i - ペンタイル・i - ペンタイル・i - ペンタイル・i

20

30

40

50

ノール、sec‐ヘキサノール、2‐エチルブタノール、sec‐ヘプタノール、ヘプタノール・3、n‐オクタノール、2‐エチルヘキサノール、sec‐オクタノール、n‐ノニルアルコール、2,6‐ジメチルヘプタノール・4、n‐デカノール、sec‐ウンデシルアルコール、トリメチルノニルアルコール、sec‐テトラデシルアルコール、sec‐ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5‐トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒;

## [0072]

エチレングリコール、1,2-プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ペンタンジオール-2,4、2-メチルペンタンジオール-2,4、ヘキサンジオール-2,5、ヘプタンジオール-2,4、2-エチルヘキサンジオール-1,3、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価アルコール系溶媒;

エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノへキシルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノ・2・エチルブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒:

などを挙げることができる。これらのアルコール系溶媒は、 1 種あるいは 2 種以上を同時 に使用してもよい。

## [0073]

# [0074]

アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N-エチルホルムアミド、N,N-ジエチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、N-ボルミルモルホリン、N-ホルミルピペリジン、N-ホルミルピロリジン、N-アセチルモルホリン、N-アセチルピペリジン、N-アセチルピロリジンなどが挙げられる。これらアミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

### [0075]

エステル系溶媒としては、ジエチルカーボネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチル、酢酸メチル、酢酸エチル、 - ブチロラクトン、 - バレロラクトン、酢酸 n - プロピル、酢酸 i - ブチル、酢酸 s e c - ブチ

### [0076]

### [0077]

このようにして得られる本発明の膜形成組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。膜形成組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および前記有機溶剤による希釈によって行われる。

# [0078]

5.ポリマー膜

本発明のポリマー膜は、上記膜形成用組成物を塗布して塗膜を形成した後、塗膜を加熱 および / または高エネルギー線照射するによって得られる。

本発明の膜形成組成物を、シリコンウエハ、 $SiO_2$ ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられる。

# [0079]

この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~2.5 $\mu$ m、2回塗りでは厚さ0.1~5.0 $\mu$ mの塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは通常80~600、好ましくは30~450、より好ましくは60~430の温度で、通常5~240分程度、加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の塗膜を形成することができる。

## [080]

この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。

### [0081]

- また、前記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒素 、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することができる。

# [0082]

10

20

30

20

30

40

50

本発明では、膜形成用組成物を基板に塗布し、高エネルギー線照射下で通常 2 5 ~ 5 0 0 、好ましくは 3 0 ~ 4 5 0 、より好ましくは 6 0 ~ 4 3 0 に加熱することができる。

### [0083]

高エネルギー線としては、電子線、紫外線および X 線から選ばれる少なくとも 1 種の高エネルギー線であることができる。以下に、一例として電子線を使用した場合の照射条件を記す。

# [0084]

ここで、電子線を照射する場合のエネルギー(加速電圧)は0.1~50keV、好ま しくは 1 ~ 3 0 k e V、電子線照射量は 1 ~ 1 0 0 0 μ C / c m <sup>2</sup>、好ましくは 1 0 ~ 5 0 0 μ C / c m<sup>2</sup> である。また、加速電圧が、 0 . 1 ~ 5 0 k e V であると電子線が膜を 透過して下部の半導体素子へダメージを与えることがなく、塗膜内部にまで電子線を十分 に進入させる事ができる。さらに、電子線照射量が1~1000μ C / c m <sup>2</sup> であると、 塗膜全体を反応させ、かつ塗膜へのダメージも少なくなる。電子線照射時の基板温度は、 通常25~500 、好ましくは30~450 である。塗膜の電子線照射に先立ち基板 を250~500 に熱した状態で本発明の塗膜を予め熱硬化させた後、電子線を照射す る事もできる。この方法によると、電子線照射量の不均一性に依存する膜厚ムラを低減す ることが可能であり有効である。電子線照射は酸素濃度が10,000ppm以下、好ま しくは 1 , 0 0 0 p p m の雰囲気下で行うことが好ましい。また、電子線照射は、不活性 ガス雰囲気下で行うこともできる。ここで、使用される不活性ガスとはNっ、He、Ar KrおよびXe、好ましくはHeおよびArなどを挙げることができる。電子線照射を 不活性ガス雰囲気下で行うことにより膜が酸化されにくくなり、得られる塗膜の低誘電率 を維持する事ができる。電子線照射は、減圧雰囲気で行っても良く、その減圧度は、通常 1000mTorr以下、好ましくは1~200mTorrの範囲である。また、電子線 硬化に要する時間は、該して1分から5分ほどであり、熱硬化の場合に要する15分~2 時間に比べて著しく短くてすみ、電子線照射はウエハーの枚葉処理に適しているといえる

### [0085]

このようにして得られる本発明のシリカ系のポリマー膜は、膜密度が、通常、0.35~1.2 g / c m 3 、好ましくは0.4~1.1 g / c m 3 、さらに好ましくは0.5~1.0 g / c m 3 である。膜密度が0.35 g / c m 3 未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.2 g / c m 3 を超えると低比誘電率が得られない。さらに、本発明のポリマー膜の比誘電率は、通常、3.2~1.2 、好ましくは3.0~1.5 、さらに好ましくは2.7~1.8 である。

# [0086]

本発明によって得られたポリマー膜は、膜構造中にケイ素・炭素結合を多く有するという特徴を有する。また、本発明によって得られたポリマーは、加水分解性基含有シラン化合物および / またはその加水分解縮合物と、環状シランモノマーとを共存させた状態で加水分解・縮合することにより、ポリシロキサンとポリカルボシランとが複合化されたポリマーである。このポリマーは、共縮合物であるので、ポリシロキサンとポリカルボシランとをブレンドした場合のように、膜中に相分離を発生することがなく、均質な膜を得ることができる。このポリマーを含有する膜形成用組成物を用いることにより、比誘電率が小さく、機械的強度、СМР耐性ならびに薬液耐性に優れたポリマー膜を得ることができる

### [0087]

本発明のポリマー膜は、低比誘電率でかつ機械的強度、CMP耐性ならびに薬液耐性に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D-RDRAM、CD-RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。

### [0088]

6.実施例

以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。本発明は以下の実施例に限定 されるものではない。なお、実施例および比較例中の「部」および「%」は、特記しない 限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。

- [0089]
  - 6 . 1 . 評価方法

各種の評価は、次のようにして行なった。

- [0090]
  - 6 . 1 . 1 . ポリマーの重量平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)法により測定した

[0091]

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、ポリマー(共縮合物)1gを、100 ccのテトラヒドロフランに溶解して調製した。

[0092]

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用した。

[0093]

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマトグラム(モデル150.C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M(長さ50cm)

測定温度: 40 流速:1 c c / 分

[0094]

6 . 1 . 2 . 比誘電率

得られたポリマー膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ、比誘 電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒ ューレットパッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284Aプレシジョ ンLCRメータを用いて、CV法により室温における当該ポリマー膜の比誘電率を測定し た。

[0095]

6 . 1 . 3 . 機械的強度(弾性率・硬度)

MTS社製超微少硬度計(Nanoindentator XP)にバーコビッチ型圧 子を取り付け、得られたポリマー膜のユニバーサル硬度を求めた。また、ポリマー膜の弾 性率は連続剛性測定法により測定した。

[0096]

6 . 1 . 4 . C M P 耐性

得られたポリマー膜を以下の条件で研磨した。

[0097]

スラリー:シリカ - 過酸化水素系

研磨圧力: 2 8 0 g / c m<sup>2</sup>

研磨時間:120秒

CMP後の膜の外観を35万ルクスの光源で観察し、以下の基準で評価した。

[0098]

A:変化無し。

[0099]

B:膜に傷や剥がれが確認される。

[0100]

6 . 1 . 5 . 薬液耐性

ポリマー膜が形成された8インチウエハーを、室温で0.2%の希フッ酸水溶液中に1

20

10

30

40

分間浸漬し、ポリマー膜の浸漬前後の膜厚変化を観察した。下記に定義する残膜率が99%以上であれば、薬液耐性が良好である(表1における「A」)と判断し、上記残膜率が99%未満である場合、薬液耐性が良好でない(表1における「B」)と判断した。

### [0101]

残膜率(%)=(浸漬後の膜の膜厚)÷(浸漬前の膜の膜厚)×100

6.2. 実施例,比較例

### [0102]

6 . 2 . 1 . 実施例 1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン 5 5 g、 1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジエトキシ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン 3 6 g、およびテトラプロピルアンモニウムハイドロオキサイドの 2 0 % 水溶液 1 6 gを、メタノール 5 0 0 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を 5 5 に安定させた。次に、イオン交換水 4 4 g とプロピレングリコールモノエチルエーテル 5 0 0 gの混合溶液を 1 時間かけて溶液に添加した。

## [0103]

その後、55 で4時間反応させたのち、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液22gを添加し、さらに30分間反応させ、溶液を室温まで冷却した。50 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H-1)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、52,000であった。

[0104]

6 . 2 . 2 . 比較例 1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン 4 0 g、テトラメトキシシラン 1 8 g、 1 , 3 - ジメチル - 1 , 3 - ジエトキシ - 1 , 3 - ジシラシクロブタン 3 6 g、およびテトラプロピルアンモニウムハイドロオキサイドの 2 0 % 水溶液 1 7 gを、メタノール 5 0 0 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を 5 5 に安定させた。次に、イオン交換水 4 7 gとプロピレングリコールモノエチルエーテル 5 0 0 g の混合溶液を 1 時間かけて溶液に添加した。

[0105]

その後、55 で4時間反応させたのち、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液24gを添加し、さらに30分間反応させ、溶液を室温まで冷却した。50 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H-2)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、61,000であった。

[0106]

6 . 2 . 3 . 実施例 2

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン71g、1,1,3,3-テトラメトキシ-1,3-ジシラシクロブタン27g、およびテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの20%水溶液21gを、メタノール500gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を55 に安定させた。次に、イオン交換水58gとプロピレングリコールモノエチルエーテル500gの混合溶液を1時間かけて溶液に添加した。

[0107]

その後、55 で4時間反応させたのち、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液29gを添加し、さらに30分間反応させ、溶液を室温まで冷却した。50 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H-3)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、74,000であった。

[0108]

6 . 2 . 4 . 比較例 2

20

10

40

30

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン46g、テトラメトキシシラン31g、1,1,3,3-テトラメトキシ-1,3-ジシラシクロブタン28g、およびテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドの20%水溶液24gを、メタノール500gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を55 に安定させた。次に、イオン交換水65gとプロピレングリコールモノエチルエーテル500gの混合溶液を1時間かけて溶液に添加した。

### [0109]

その後、55 で4時間反応させたのち、酢酸の10%プロピレングリコールモノプロピルエーテル溶液32gを添加し、さらに30分間反応させ、溶液を室温まで冷却した。50 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H-4)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、82,000であった。

## [0110]

6 . 2 . 5 . 実施例 3

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン 5 8 g と、1 , 1 , 3 , 3 , 5 , 5 - ヘキサクロロ - 1 , 3 , 5 - トリシラシクロヘキサン 4 1 g ならびにイオン交換水 5 6 g とを、プロピレングリコールモノエチルエーテル 5 0 0 0 g に溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を 5 5 に安定させた。その後、 5 5 で 4 時間反応させたのち、溶液を室温まで冷却した。 5 0 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H - 5)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、 5 , 3 0 0 であった。

#### [0111]

6.2.6.比較例3

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシラン42gと、テトラメトキシシラン19g、1,1,3,3, 5,5-ヘキサクロロ-1,3,5-トリシラシクロヘキサン42gならびにイオン交換水61gとを、プロピレングリコールモノエチルエーテル5000gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を55 に安定させた。その後、55 で4時間反応させたのち、溶液を室温まで冷却した。50 で溶液からメタノールと水とを含む溶液をエバポレーションで除去し、溶液(H-6)を得た。このようにして得られた本発明の縮合物の重量平均分子量は、6,800であった。

### [0112]

6 . 2 . 7 . 実施例 4 - 6、比較例 4 - 6

実施例 1-3、ならびに比較例 1-3 で得られた溶液 H-1、 H-2、 H-3、 H-4 、 H-5、 H-6 を 0.2  $\mu$  m 径のテフロン(登録商標)製フィルターでろ過を行い、本発明の膜形成用組成物を得た。

### [0113]

得られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布したのち、ホットプレート上で90 で3分間、窒素雰囲気200 で3分間基板を乾燥し、さらに400 の窒素雰囲気ホットプレートで60分基板を焼成した。焼成後に得られたポリマー膜(以下、「シリカ系膜」という)を、前記評価方法のとおり評価した。評価結果を表1に示す。

# [0114]

10

20

30

### 【表1】

	反応液	塗膜処理 条件	膜厚 [μm]	比 誘電 率	弾性率 [GPa]	硬度 [GPa]	CMP 耐性	薬液耐性	
								1分	3分
実施例4	H-1	加熱焼成	0. 50	2. 34	5. 3	0. 6	Α	Α	Α
実施例5	H-3	加熱焼成	0. 50	2. 52	6. 3	0. 7	Α	Α	Α
実施例6	H-5	加熱焼成	0. 50	2. 73	8. 7	1. 1	Α	Α	Α
比較例4	H-2	加熱焼成	0. 50	2. 41	5. 9	0. 7	Α	Α	В
比較例5	H-4	加熱焼成	0. 50	2. 56	7. 1	0.8	Α	Α	В
比較例6	H-6	加熱焼成	0. 50	2. 81	9. 1	1. 2	Α	Α	В

10

# [0115]

# 6 . 3 . 評価結果

実施例4~6から明らかであるが、本発明のポリマー膜形成用組成物を用いて作成した絶縁膜は、比較例4~6と比べて誘電率が低く、薬液耐性が高いことがわかった。

# [0116]

以上の実施例からも明らかであるように、本発明のポリマーの製造方法を用いてポリマーを形成し、該ポリマーを含むポリマー膜形成用組成物を用いることにより、比誘電率が低く、機械的強度、CMP耐性、および薬液耐性に優れたシリカ系絶縁膜の形成が可能である。したがって、本発明のシリカ系膜は、機械的強度、CMP耐性、および薬液耐性に優れ、比誘電率が低いため、半導体装置の層間絶縁膜などとして好適に用いることができる。

# フロントページの続き

(72)発明者 服部 清太郎

東京都中央区築地5丁目6番10号 JSR株式会社内

(72)発明者 秋山 将宏

東京都中央区築地5丁目6番10号 JSR株式会社内

審査官 天野 宏樹

(56)参考文献 特開2005-200571(JP,A)

特開2005-350653(JP,A)

国際公開第2005/068538(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

C 0 9 D

C 0 8 G 7 7

C 0 8 L 8 3

B 0 5 D 7

H01L21/312

CA/REGISTRY(STN)